

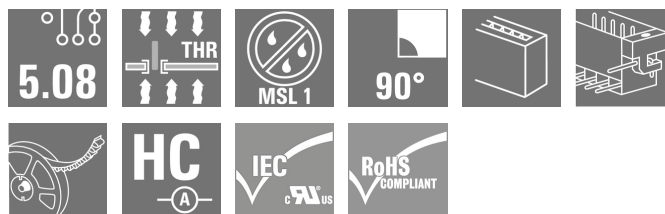
SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Connecteur mâle résistant aux températures élevées, avec conditionnement en boîte ou en rouleau. En rouleau, avec picot à souder 1,5 mm, optimisé pour l'implantation automatique. Longueurs de picots de 3,2 mm indiquées pour les applications de soudure à la vague et par refusion. Les connecteurs mâles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|---|
| Version | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT/THR, 5.08 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, étamé, noir, Tape |
| Référence | 1374890000 |
| Type | SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL |
| GTIN (EAN) | 4050118175974 |
| Qté. | 300 pièce(s) |
| Indices de produit | IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
| Emballage | Tape |

Date de création 2 octobre 2024 14:40:18 CEST

SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur | 12 mm | Profondeur (pouces) | 0,472 inch |
| Hauteur | 10 mm | Hauteur (pouces) | 0,394 inch |
| Hauteur version la plus basse | 8,5 mm | Largeur | 70,76 mm |
| Largeur (pouces) | 2,786 inch | Poids net | 5,25 g |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002637 | ETIM 7.0 | EC002637 |
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 | | |

Caractéristiques du système

| | | | |
|--|------------------------------------|---|---|
| Famille de produits | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 | Type de raccordement | Raccordement sur platine |
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR | Pas en mm (P) | 5,08 mm |
| Pas en pouces (P) | 0,2 " | Angle de sortie | 90° |
| Nombre de pôles | 12 | Nombre de picots par pôle | 1 |
| Longueur du picot à souder (l) | 1,5 mm | Tolérance sur la longueur du picot à souder | 0 / -0,3 mm |
| Dimensions du picot à souder | d = 1,2 mm, octogonal | L1 en mm | 55,88 mm |
| L1 en pouce | 2,2 " | Nombre de séries | 1 |
| Nombre de pôles | 2 | Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt non enfiché/ protection appui de la main enfiché |
| Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 enfiché/ IP 10 non enfiché | Degré de protection | IP20 |
| Résistance de passage | ≤5 mΩ | Codable | Oui |
| Force d'enfichage/pôle, max. | 9 N | Force d'extraction/pôle, max. | 7 N |

Données des matériaux

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Matériau isolant | LCP GF | Couleur | noir |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 | Groupe de matériaux isolants | IIIa |
| Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 175 | Moisture Level (MSL) | 1 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Surface du contact | étamé | Structure en couches du raccordement soudé | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat |
| Structure en couches du contact mâle | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat | Température de stockage, min. | -40 °C |
| Température de stockage, max. | 70 °C | Température de fonctionnement, min. | -50 °C |
| Température de fonctionnement, max. | 100 °C | Plage de température montage, min. | -30 °C |
| Plage de température montage, max. | 100 °C | | |

SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon CEI

testé selon la norme

IEC 60664-1, IEC 61984

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 20 °C)

19 A

Courant nominal, nombre de pôles max.

(Tu = 40 °C)

16,5 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

320 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

4 kV

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

4 kV

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 20 °C)

27,5 A

Courant nominal, nombre de pôles min.

(Tu = 40 °C)

24 A

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution II/2

400 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/3

250 V

Tension de choc nominale pour classe

de surtension/Degré de pollution III/2

4 kV

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation

B / CSA)

300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation B /

CSA)

18,5 A

Tension nominale (groupe d'utilisation

D / CSA)

300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation

D / CSA)

18,5 A

Données nominales selon UL 1059

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E60693

Tension nominale (groupe d'utilisation

B / UL 1059)

300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation B /

UL 1059)

18,5 A

Référence aux valeurs approuvées

Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Tension nominale (groupe d'utilisation

D / UL 1059)

300 V

Courant nominal (groupe d'utilisation

D / UL 1059)

10 A

Emballage

Emballage de niveau ESD

dissipatif statique

Longueur VPE

361 mm

Hauteur VPE

102 mm

Largeur du ruban (W)

88 mm

Hauteur ruban (AO)

12,3 mm

Séparation ruban (P1)

16 mm

Séparation ruban (F)

42,2 mm

Résistance de la surface

 $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$

Emballage

Tape

Largeur VPE

329 mm

Profondeur ruban (T2)

13 mm

Profondeur du ruban (K0)

12,5 mm

Largeur du ruban (B0)

71,4 mm

Orifice de séparation ruban (E)

1,75 mm

Diamètre de bobine du ruban Ø (A)

330 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC

/

Statut de conformité RoHS

Conforme sans exemption

SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Note importante**

| | |
|----------------|---|
| Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> • Surfaces de contact dorées sur demande • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Diamètre du trou d'implantation D = 1,4+0,1 mm • Diamètre du trou d'implantation D = 1,5 + 0,1 mm à partir de 9 pôles • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E60693 |

Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Notification de modification produit | PCN 2015 208 PL30X SC-SMT SL SMT 3.xx 5.xx neue Tapeverpackung Step 4 DE PCN 2015 208 PL30X SC-SMT SL SMT 3.xx 5.xx new Tape Packaging Step 4 EN Changeover to ESD bags for "Tape on Reel" products Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL DRIVES EN FL DRIVES DE |
| Livre blanc technologie de montage en surface | Download Whitepaper |

SL-SMT 5.08HC/12/90LF 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

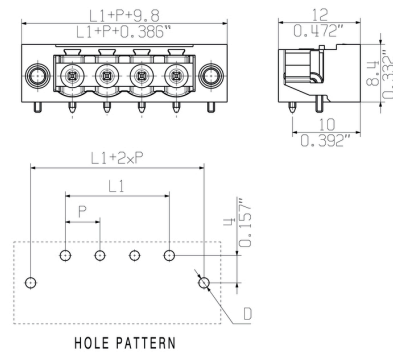
www.weidmueller.com

Dessins

Illustration du produit



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Exemple d'utilisation



Avantages produit



Safe power transmission
Proven properties

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.